

中国国际金融股份有限公司
关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“龙迅股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责龙迅股份的持续督导工作，并针对公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）经营情况，出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与龙迅股份签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解龙迅股份业务情况，对龙迅股份开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在持续督导期间龙迅股份未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施	在持续督导期间龙迅股份未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的	在持续督导期间，保荐机构督导龙迅股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和

序号	工作内容	持续督导情况
	各项承诺	上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促龙迅股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、控股子公司管理等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对龙迅股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，龙迅股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促龙迅股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对龙迅股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，龙迅股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，龙迅股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他	本持续督导期间，龙迅股份未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	本持续督导期间，龙迅股份不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集型的特征，其特点为快速的技术演进及持续的产品升级。公司主营业务所在的智能视频芯片、互连芯片细分领域的技术与方案伴随着终端需求的变化也不断推陈出新，公司需要持续不断地推出符合技术发展方向与市场需求趋势的新产品才能维持并提升公司的竞争力。如果未来公司技术迭代创新和产品升级换代未达到预期，难以满足市场需求的最新变化，可能会使得公司在市场竞争中处于不利地位，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来业务发展造成不利影响。

2、研发失败风险

公司主营业务为智能视频芯片与互连芯片的研发设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定研发方向，持续进行现有产品线的升级与新产品的开发，以适应不断变化的市场需求。由于新技术与产品的研发与产业化具有一定的不确定性，如果公司的研发创新方向与行业发展趋势出现较大偏离，或相关研发成果短期内无法产业化，公司将面临研发失败的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过十多年来持续的技术积累，公司储备了一系列拥有自主知识产权的核心技术。如未来因研发人员流失、关键信息泄露、核心技术保管不善等因素导致核心技术泄密，将对公司业务造成不利影响。

(二) 经营风险

1、市场竞争加剧风险

公司业务所处领域整体有较高的技术壁垒，需要长时间的技术积累，而中国大陆企业在该领域起步相对较晚，目前市场竞争格局仍主要由境外公司所主导，公司各类产品目前国产化率尚处于较低水平。公司相较于海外领先竞争对手，在整体规模、研发实力、营销网络、客户资源、融资渠道等诸多方面仍存在差距。同时，随着中国半导体产业整体设计能力的进步，公司也会面临本土芯片设计公司在细分产品市场的竞争。在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，竞争决策失误、市场拓展不力，则公司的市场地位与经营业绩等可能受到不利影响。

2、供应商集中度高风险

公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计和销售，生产环节主要委托晶圆代工厂和封装测试公司进行制造加工。报告期内，公司向前五名供应商采购金额占同期采购总额的比例相对较高，供应商整体集中度较高；其中，境外晶圆供应商主要有 Silterra 和联华电子，境外封测供应商主要有超丰电子，境外供应商占比及集中度较高。未来若公司合作的主要供应商因贸易摩擦、产能受限或者关系恶化等各种原因不能如期或足量供货，将对公司生产经营造成不利影响。

3、客户相对集中风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高，客户集中度较高。与公司主要客户业务的持续性对公司的业务和财务表现较为重要，如果未来公司主要客户因为内部采购调整、下游客户需求改变、竞争加剧、产品效能问题或其本身的营运或财务状况等各种原因而减少采购量或终止与公司的合作关系，将对公司经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、收入波动及未来业绩快速增长不可持续的风险

公司业务规模增长受智能视觉终端、智能车载、AR/VR 以及 AI&HPC 等领域下游市场需求影响较大，若全球或国内宏观经济持续波动、半导体产业放缓或产业政策发生重大不利变化，可能导致公司产品下游市场需求下降，进而对公司的销售收入和经营业绩造成不利影响。同时，产品和技术升级迭代及市场竞争格局变化也将对公司业绩产生影响，若公司技术实力停滞不前、市场竞争加剧或市场环境发生重大不利变化，可能导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司存在未来业绩快速增长不可持续、业绩大幅波动或下滑的风险。

2、毛利率波动风险

公司产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司设计能力、竞争格局等多种因素影响，若上述因素发生不利变动，可能导致公司毛利率下降，从而影响公司盈利能力。

3、存货跌价风险

公司因产品品类丰富、应用领域广泛、生产周期较长等因素，需保持较高规模的存货储备，且随着业务扩张可能进一步增加。若未来下游市场需求下降或晶圆等原材料价格出现大幅下跌，公司将面临大幅计提存货跌价准备的风险，可能导致公司经营业绩下滑，给公司生产经营和财务状况带来不利影响。

（四）行业风险

公司所处集成电路设计行业是半导体产业的重要环节，半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，与宏观经济环境及下游应用市场需求的波动密切

相关。若未来半导体产业周期出现较大波动，可能对公司的经营业绩造成不利影响。同时，半导体产业是国民经济和社会发展的战略性产业，国家政策对半导体产业发展有较大影响。当前，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

（五）宏观环境风险

1、贸易摩擦及贸易政策变动风险

报告期内，公司境外销售比例较高，主要集中在中国香港、中国台湾、韩国、日本等地区或国家。同时，公司晶圆制造及封装测试服务境外采购比例高，主要集中在马来西亚、中国台湾。未来如果全球贸易摩擦加剧，相关国家或地区采取限制性的贸易政策，境外客户可能会采取减少订单、要求公司降价或者承担额外的关税成本等措施，境外供应商可能会被限制或禁止向公司提供产品或服务，上述情况会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司作为高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业，享受10%的企业所得税优惠税率等税收优惠政策。若国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业认定，则可能面临因税收优惠减少或取消而导致盈利能力下降的风险。

3、汇率波动风险

公司同时进行境外采购和销售交易，主要以美元进行结算。未来若人民币兑美元汇率发生大幅波动以及未来公司经营规模持续扩大后以美元计价的销售额和采购额进一步增长，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩造成不利影响。

（六）其他重大风险

1、法律风险

（1）知识产权相关风险

公司拥有的商标、专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。随着智能视频芯片、互连芯片及相关领域市场竞争日趋激烈，公司未来可能出现知识产权被第三方侵犯、知识产权涉及侵权诉讼或纠纷等情形。如果公司通过法律途径寻求保护，可能将为此付出较大的人力、物力及时间成本，并分散公司的管理及财务资源，从而导致公司商业利益受到一定程度的损失。如公司相关核心技术被竞争对手所获知并效仿，或者第三方侵犯公司知识产权的行为得不到及时防范和制止，可能对公司未来业务发展和生产经营产生负面影响。

(2) 产品质量相关风险

随着公司经营规模的持续扩大，对质量控制能力的要求逐步提高。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，产品出现质量问题，可能导致与客户发生潜在诉讼或纠纷，影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、内控风险

(1) 经营规模扩大带来的管理风险

随着公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入和资产规模会进一步扩大，从而在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管理风险。

(2) 内控制度建设和执行的风险

内部控制制度是保障企业财产与会计信息的完整性、安全性以及可靠性的关键制度。如果公司未来不能随着业务规模的发展而及时调整完善有关内部控制制度及体系，或者有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将影响企业管理的有效性，不利于维护公司财产安全并保持经营业绩的稳定增长。

3、预测性陈述存在不确定的风险

公司在 2025 年年报中所涉预测性的陈述，例如涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的

预期或相关讨论。尽管公司及公司管理层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎和合理的，但亦需要提请投资者注意，该等预期或讨论是否能够实现仍然存在较大不确定性。鉴于该等预期与讨论均有风险及不确定性因素，公司 2025 年年报载明的任何预测性及前瞻性陈述，不应被视为公司的承诺与声明。

4、股票价格波动风险

股票价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济、资本市场资金供求关系、投资者情绪、国际环境等外部因素的影响。公司股票价格可能因上述因素而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

四、重大违规事项

2025 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	568,203,739.71	466,002,733.23	21.93
利润总额	174,673,924.85	152,946,961.67	14.21
归属于上市公司股东的净利润	171,915,593.75	144,411,417.58	19.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,450,810.41	111,425,364.58	29.64
经营活动产生的现金流量净额	112,413,955.79	116,888,052.59	-3.83
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,559,490,474.21	1,431,799,478.55	8.92
总资产	1,658,009,876.29	1,502,359,846.45	10.36

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.30	1.09	19.27

稀释每股收益（元 / 股）	1.30	1.09	19.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.09	0.84	29.76
加权平均净资产收益率（%）	11.66	10.22	增加 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.79	7.88	增加 1.91 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.93	21.45	减少 1.52 个百分点

注：本年度内因公司实施公积金转增股本方案，增加了报告期内股份数量，为保持可比性，对以前年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标同步进行调整

2025 年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

报告期内，公司实现营业收入 56,820.37 万元，较上年同期增长 21.93%；归属于母公司所有者的净利润 17,191.56 万元，较上年同期增长 19.05%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,445.08 万元，较上年同期增长 29.64%。报告期末，公司总资产为 165,800.99 万元，较报告期初增长 10.36%；归属于母公司的所有者权益为 155,949.05 万元，较报告期初增长 8.92%。报告期内，公司持续迭代升级产品，提升产品性能，积极开发新产品，丰富产品矩阵，积极开拓国内外市场，实现营收规模的稳步增长。

综上，公司 2025 年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、独有的技术平台与持续的创新研发能力优势

通过持续的研发投资和深耕布局，公司已成功构建了以高带宽 SerDes 技术、高速接口协议处理与数据加密技术、高清音视频处理与显示驱动技术为核心的具有自主知识产权的 ClearEdge 技术平台。该平台形成了兼具专业性、兼容性与扩展性的技术体系，其中高带宽 SerDes 技术作为数据传输的核心枢纽，可实现超高速率、低延迟的信号传输，解决高速数据交互的痛点，适配大数据、云计算等高频数据传输场景；高速协议处理技术能够高效解析、适配各类主流高速通信协议，保障不同设备、不同场景下的数据交互顺畅性与兼容性，降低多场景应用的技术适配成本；数

据加密技术采用先进的加密算法，全方位守护数据传输与存储过程中的安全性；高清视频处理及显示驱动技术则可实现高清、超高清视频的高效解码、渲染与显示控制，适配智能终端、车载显示、专业显示等多元化显示场景，为用户带来清晰、流畅的视觉体验。依托这一完善的技术平台，公司实现了核心技术能力的模块化、标准化整合，能够根据不同行业、不同客户的个性化需求，快速复用现有技术模块、灵活扩充新的技术功能，无需进行全流程的技术重构，大幅缩短产品研发周期、降低研发成本。同时，平台具备极强的迭代升级能力，能够紧跟全球芯片产业技术演进趋势和客户需求变化，持续优化技术性能、补充技术模块，精准匹配全球客户群在智能化、高清化、安全化、高效化等方面不断演进的核心需求，为全球合作伙伴提供兼具灵活性、高效能与成本效益的定制化芯片产品，助力客户提升产品竞争力，进一步巩固公司在芯片设计领域的技术优势与市场地位。

公司始终将研发创新视为企业发展的源动力，持续创新能力是公司重要的竞争优势。为保持能够持续不断的创新，公司以市场和客户需求为创新导向，打造了良好的研发环境，建立了科学的项目开发和管理体系，制定了人才培养、考核和激励机制，为新技术、新产品及产品升级的开发提供有利保障。2025年，公司持续加大在各产品条线的研发投入，进一步提升研发平台硬件设施水平，壮大研发团队，优化组织架构，为产品升级及新品开发提供充分保障，全年累计投入11,324.81万元，较上年同期增加13.28%，占营业收入比重为19.93%。公司持续稳定的研发投入，为产品升级及新产品、新技术的开发提供有利保障，稳步提升公司的核心竞争力。

2、结构丰富且具备市场竞争力的产品优势

公司成立以来始终以市场为导向，致力于为客户提供高性能的高速混合信号芯片产品。通过多年市场耕耘，公司目前已拥有超过200款不同型号的智能视频芯片和互连芯片产品，产品普遍具有高集成度、高性能、低功耗的优势。公司智能视频芯片不仅支持主流信号协议之间的无缝转换，还集成了视频图像的分割、缩放、旋转、存储、压缩、解压、色彩空间转换与增强、显示控制、背光控制等处理功能；互连芯片在处理各类信号高速传输的过程中，能实现中继、分配、切换和矩阵交换等功能，可为客户提供多样化的芯片解决方案。

同时，依托在相关细分领域的长期技术积淀，公司持续推动产品高效迭代，并

基于对市场需求的深度洞察，不断为新兴应用场景提供创新芯片解决方案。智能视觉终端领域，智能视频芯片广泛应用于商用显示器、个人电脑、无人机、机器人及其他视觉显示与处理场景；智能汽车领域，已有 19 款芯片型号通过 AEC-Q100 认证，成功融入全球主要汽车 OEM 供应链，自主研发的车载 SerDes 芯片更延伸至摄像云台、无人机等新应用场景；AR/VR 领域，产品及解决方案已被全球领先品牌的多款量产机型采用，行业影响力稳步提升；AI 领域，PCIe to SATA 和 HDMI to PCIe 等芯片已完成验证，目前正全力推进 PCIe/CXL/USB Retimer 研发工作，重点聚焦 AI PC 与服务器市场，从而进一步扩大产品市场影响力。

3、优质客户与产业生态优势

通过多年来在高速混合信号芯片领域的持续深耕，公司的技术能力和产品性能已逐步在产业链内形成了优质的品牌声誉。公司秉持以客户为中心的核心发展理念，通过持续迭代核心技术，精准匹配并赋能客户多元化开发需求，维系长期稳定的合作关系，凭借扎实的技术积淀与可靠的产品实力，获得了全球头部客户的高度认可与深度信赖。同时，公司与产业价值链中的主要厂商建立了定期的技术对话机制，在技术演进和产品创新方面进行前瞻性的合作。通过共同研究行业趋势，参与解决方案的共同调试，确保产品能持续符合不断演进的客户需求与应用场景，深化产业生态协同效应，从而实现公司在应用领域的技术领先优势。

此外，随着技术能力的不断提升，公司积极与主芯片厂商进行沟通合作，以期更好把握行业前沿的技术趋势和市场机遇。目前与英伟达、高通及英特尔等全球领先的芯片厂商保持紧密的协同合作关系，多款芯片成功集成至其官方参考设计平台中，实现软硬件生态的深度兼容与协同优化，不仅为下游客户提供了更便捷、高效的集成方案，降低研发成本与适配风险，更助力公司精准对接行业技术迭代方向，持续强化核心技术竞争力，进一步深化与全球顶尖芯片生态的绑定，巩固在高速混合信号芯片领域的行业地位。

4、高效灵活的双轨供应链体系

公司始终将供应链建设作为核心竞争力之一，与全球范围内多家领先的晶圆代工厂、封装测试服务供应商建立了长期、紧密的战略合作关系。通过建立常态化沟通机制、联合质量管控体系以及协同生产计划，从芯片研发试产到批量量产的全流

程，与合作伙伴深度联动，严格把控每一个环节的产品质量，确保交付的芯片全面满足全球客户在性能、可靠性、合规性的严苛标准，为客户构建市场核心竞争力提供有力支撑。

同时，为提升供应链抗风险能力与供应灵活性，应对全球供应链波动、地区政策调整、地缘政治变化等潜在挑战，公司构建了完善的双轨供应系统，整合调配国内外优质制造资源。国内制造资源凭借响应高效、协同便捷的优势，可快速响应国内及周边客户交付需求，提升交付效率与服务质量；国际制造资源则依托成熟的技术体系、广泛的全球布局，支撑海外市场的产品供应与技术服务。这种双轨互补的供应结构，不仅能够精准匹配不同地区客户的多样化、个性化需求，更能有效规避单一供应源带来的风险，保障供应链在各类复杂环境下的稳定运行，为公司全球业务的持续推进提供坚实支撑。

此外，公司在深化与供应商合作的基础上，与上游核心伙伴持续开展深度的技术交流与前瞻性战略合作，双方共享产业发展洞察、技术研发经验以及市场需求趋势，携手攻克晶圆制造、封装测试领域核心技术痛点，推动技术迭代升级与创新应用。通过共享研发资源、协同推进产品验证，加速技术成果转化，助力公司优化产品性能、控制成本、简化研发流程，强化与上游伙伴的共生共赢关系，提升市场及客户需求响应能力，持续巩固行业核心竞争力。

5、经验丰富的管理和研发团队

公司管理团队汇聚了一批富有远见且经验丰富的核心领导者，核心成员均在高速混合信号芯片设计领域深耕多年，拥有深厚专业储备、敏锐行业洞察力及高效经营管理能力，为公司稳健发展筑牢根基。董事长 FENG CHEN 博士曾任职于英特尔公司，专注于高速 CPU、I/O 等核心芯片设计与研发优化，积累了前沿技术经验与优质产业资源，凭借对全球半导体行业趋势、技术迭代及产业动态的精准洞察与深刻研判，带领团队捕捉关键市场机遇，搭建强大且可扩展的技术基础架构，坚持创新驱动与差异化发展战略，引领公司在行业发展中保持领先，推动公司实现跨越式发展。

公司管理团队全体成员均具备扎实的集成电路产业经验，核心成员在技术研发、市场销售、运营管理等关键领域各有专长，兼具过硬专业能力与实战管理经验，可

高效统筹各项业务，构建协同高效、权责清晰的管理体系。同时，公司高度重视研发技术团队的建设，始终以人才培养与技术创新为核心战略，通过完善的培养体系、有竞争力的激励机制及良好创新氛围，培养出数百名专注于高速、低功耗和数模混合电路设计的专业技术人才，打造了稳定、专业、富有创新活力的核心技术人才队伍。截至报告期末，研发人员达 192 名，占员工总数 75%。这支富有创造力的高素质人才队伍，既是当前技术研发、产品创新的核心骨干，也为公司未来技术攻关、产品迭代、市场拓展提供了有力人才支撑，为公司持续深耕核心技术领域、突破关键技术瓶颈奠定了坚实基础。

（二）核心竞争力变化情况

2025 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：元

主要会计数据	2025 年度	2024 年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	113,248,090.73	99,968,595.30	13.28
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	113,248,090.73	99,968,595.30	13.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	19.93	21.45	减少 1.52 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

（二）研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司坚持深耕于高速混合信号芯片领域，凭借长期自主研发沉淀的技术实力，搭建了专有的自研 ClearEdge 技术平台，该平台以高带宽 SerDes 技术、高速接口协议处理与数据加密技术、高清音视频处理与显示驱动技术三大技术为核心支柱，构建起自主可控、体系完整的核心技术架构。作为公司保持行业技术领先的核心支撑，该平台通过持续技术创新与高效产品迭代，在运行效能、功能扩展性、成本控制效

益三大核心维度，形成全面稳定的竞争优势。依托成熟的平台化架构，公司的技术可在各类应用场景实现快速复用与灵活拓展，助力公司精准响应全球客户不断迭代的差异化需求，交付兼具灵活性、高性能与成本优势的定制化芯片产品。

（1）高带宽 SerDes 技术

高带宽 SerDes 技术作为先进电子系统高速数据传输的核心底层支撑，是驱动智能视觉终端、智能车载、AR/VR、AI&HPC 等新兴高景气赛道性能迭代的关键核心技术。公司通过持续加大研发投入与技术攻关力度，已在该领域实现重大技术突破，构建起自主可控的技术壁垒，为公司现有产品性能迭代、下一代前沿产品规模化落地，筑牢了坚实的核心技术根基，为公司持续深耕高速数据传输领域、拓展新兴业务版图提供了强劲动能。

公司依托完全自主研发的 SerDes 核心技术，打造出适配多场景、高性能的成熟解决方案，核心技术指标与应用优势显著。针对智能视觉终端领域，可全面支持 HDMI2.1，实现单通道 12Gbps 高速传输，可稳定支持电视终端、视频会议系统实现 8K@60Hz 超高清视频传输；智能车载赛道，自研的 ADP 协议，可提供高达 8.1Gbps 的数据传输速率，精准满足智能座舱、车载智能交互系统对高速数据传输的严苛要求；AR/VR 前沿消费电子领域，可支持 DP2.1，单通道传输速率高达 20Gbps，能够足额保障新一代高分辨率、高刷新率沉浸式显示设备的带宽需求。

同时，立足行业技术发展趋势，公司同步推进 SerDes 前沿技术预研，持续突破传输速率上限，当前在研技术可实现单通道最高 32Gbps 传输速率，可兼容 PCIe5.0 等多款主流高速协议。该前瞻性布局不仅进一步拓宽了公司 SerDes 技术的应用边界，更为公司抢抓下一代高速通信、数据中心等领域发展机遇，提前储备了核心技术能力，保障公司在高速数据传输领域的长期技术领先性。

公司的 SerDes 解决方案兼具高速传输、低延迟、高可靠性及低误码率等优势，精准契合数据密集型场景的核心刚需，更是当前 AI 训练与推理系统的理想选型。在 AI 产业快速发展的背景下，数据传输与存储效率直接决定 AI 系统的整体运算性能，公司 SerDes 解决方案凭借差异化技术优势，可有效破解 AI 系统高速数据传输的瓶颈问题，保障系统稳定高效运行。这一核心优势不仅打通了公司技术与 AI 新兴赛道的联动路径，更为公司开拓 AI 相关硬件市场、培育新的业绩增长点奠定了核心基础，

助力公司把握 AI 产业发展红利，实现高质量可持续发展。

（2）高速接口协议处理与数据加密技术

公司在接口协议处理、数据加密环节构建起稳固的核心技术壁垒，形成了高速接口协议处理与数据加密技术。该技术可高效完成信号解析、转换与传输全流程处理，能够支持 HDMI、DP/eDP、USB、MIPI、LVDS、VGA、PCIe、SATA 等多种主流传输协议，具备高稳定、高效率的核心优势，精准满足智能终端、边缘设备多样化的传输与显示场景需求，为下游客户提供可靠的高性能技术支持。在 PCIe 研发方面，公司已完成 PCIe to SATA、HDMI to PCIe 等关键芯片解决方案的验证，各项效能指标行业领先。该类技术是 AI 场景中实现高效数据交互的核心支撑，具备不可替代的技术价值。

此外，为确保数据传输过程中的安全性，公司的芯片在发射端与接收端内置数据加密与解密技术模块，通过设备认证、信号加密及验证三重防护机制，仅允许授权设备解密并使用受保护内容，从源头防范未经授权的复制、截取与非法使用，筑牢数据安全防线。依托上述安全技术，公司的产品可为 4K/8K 超高清视频传输、通用数据传输等场景提供端到端安全传输解决方案。

（3）高清音视频处理及显示驱动技术

公司深耕视频处理及显示领域，核心技术已实现从视频信号输入到终端显示的全流程覆盖，集成了 Local Dimming、HDR、图像缩放、旋转、畸形校正、3D 图像分割、拼接、OSD、DSC、PIP、MST 等多功能模块，支持 4K/8K 超高清视频格式，具备低传输延迟、低功耗运行的核心性能优势，可广泛应用于城市应急指挥中心大屏、高端商用超高清显示终端等场景，能够满足各类场景下超高清视频传输与显示的严苛需求，兼顾画面清晰度与运行稳定性。另外，为保障高吞吐量视频信号的高效顺畅运行，公司依托自主研发实力独立开发了 LPDDR4、DDR3 和 PSRAM 的内存控制器技术，并已与视频处理架构紧密集成，从底层技术层面保障视频信号处理全过程的高效运转、稳定运行与实时响应，为相关业务落地与规模化应用提供坚实技术支持。

2、报告期内获得的研发成果

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 241 项，其中发明专利 218 项，占比 90.46%；授权专利 169 项，其中发明专利 147 项，占比 86.98%。2025 年度，公司申请专利 29 项，其中发明专利 29 项；授权专利 12 项，其中发明专利 12 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行股份实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，每股发行价格为人民币 64.76 元。截至 2023 年 2 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，募集资金总额为人民币 1,121,301,008.16 元，扣除各项发行费用合计人民币 91,020,020.91 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,030,280,987.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 14 日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030 号《验资报告》。

2、首次公开发行股份募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为282,030,220.56元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 2 月 14 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
一、募集资金总额	112,130.10
其中：超募资金金额	7,233.03
减：直接支付发行费用	9,102.00
二、募集资金净额	103,028.10
减：	
以前年度已使用金额	23,143.55
本年度使用金额	12,581.96
暂时补流金额	
现金管理金额	45,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.60
加：	
募集资金利息收入	5,901.02
三、报告期期末募集资金余额	28,203.02

注：上表如出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

3、首次公开发行股份募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年2月14日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
龙迅半导体（合肥）股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	551903525810903	3,183.56	使用中
龙迅半导体（合肥）股份有限公司	交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001930939	743.39	待注销
龙迅半导体（合肥）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1302011129100273322	4.16	使用中
龙迅半导体（合肥）股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	20010339250866600000011	140.03	使用中
龙迅半导体（合肥）股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	3401040160001346585	24,064.07	使用中

龙迅半导体（合肥）股份有限公司	兴业银行合肥经开区科技支行	499110100100102427	67.81	使用中
合计			28,203.02	

（二）募集资金合规情况

公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股数变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
FENG CHEN	控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员	38,495,035	50,043,545	11,548,510	资本公积转增股本
吴文彬	董事				
陈来	独立董事				
解光军	独立董事（已离任）				
黄绮汶	独立董事				
文冬梅	独立董事				
苏进	董事、副总经理、核心技术人员	340,992	366,290	25,298	资本公积转增股本、二级市场卖出

刘永跃	副总经理	369,010	479,713	110,703	资本公积转增股本
赵彧	董事会秘书		5,295	5,295	第二类限制性股票归属
韦永祥	财务负责人		5,295	5,295	第二类限制性股票归属
夏洪锋	核心技术人员	252,078	304,878	52,800	二级市场卖出、资本公积转增股本、第二类限制性股票归属
合计	/	39,457,115	51,205,016	11,747,901	/

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员 FENG CHEN，董事、副总经理、核心技术人员苏进，核心技术人员夏洪锋，高级管理人员赵彧、韦永祥通过芯财富间接持有公司股票。

报告期内，FENG CHEN 通过芯财富间接持有公司股票由 4.12 万股增加为 5.51 万股；苏进通过芯财富间接持有公司股票由 6.63 万股增加为 8.62 万股、夏洪锋通过芯财富间接持有公司股票由 6.98 万股增加为 9.07 万股、赵彧通过芯财富间接持有公司股票由 5.54 万股增加为 7.20 万股、韦永祥通过芯财富间接持有公司股票由 4.29 万股增加为 5.58 万股。

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》的有关规定，公司取消了监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，进一步提高了监督与沟通效率，确保权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

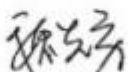
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

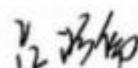
（全文结束）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



占海伟

中国国际金融股份有限公司

